

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成27年4月9日(2015.4.9)

【公表番号】特表2014-508600(P2014-508600A)

【公表日】平成26年4月10日(2014.4.10)

【年通号数】公開・登録公報2014-018

【出願番号】特願2013-555570(P2013-555570)

【国際特許分類】

A 6 1 N 1/36 (2006.01)

A 6 1 N 1/05 (2006.01)

【F I】

A 6 1 N 1/36

A 6 1 N 1/05

【手続補正書】

【提出日】平成27年2月13日(2015.2.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

埋込み可能な神経刺激器であつて、

少なくとも1つのコネクタ組立体を有し、前記少なくとも1つのコネクタ組立体は、少なくとも1つの神経刺激リードを受入れるように構成され、

更に、プログラム回路を含む回路基板と、

前記少なくとも1つのコネクタ組立体と前記回路基板の間に結合された可撓性回路と、を有する、埋込み可能な神経刺激器。

【請求項2】

前記可撓性回路は、半田付けによって前記回路基板に結合される、請求項1に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項3】

前記可撓性回路は、導電性エポキシを用いて前記回路基板に結合される、請求項1に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項4】

更に、複数のピンを含むフィードスルー組立体を有し、前記複数のピンは、前記可撓性回路に結合され、前記可撓性回路を前記少なくとも1つのコネクタ組立体に電気的に結合する、請求項1に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項5】

前記複数のピンは、金のろう付けを用いて前記可撓性回路に結合される、請求項4に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項6】

前記複数のピンは、導電性エポキシを用いて前記可撓性回路に結合される、請求項4に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項7】

前記複数のピンのうちの1つ又は2つ以上は、前記可撓性回路内の1つ又は2つ以上の孔を貫いて横切る、請求項4に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項8】

前記フィードスルー組立体は、更に、絶縁材料を収容するウェルを形成する金属フランジを含み、前記複数のピンは、前記絶縁材料を貫いて前記可撓性回路から延びる、請求項4に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項9】

前記複数のピンは、前記絶縁材料から前記少なくとも1つのコネクタ組立体まで延びる、請求項8に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項10】

前記絶縁材料から前記少なくとも1つのコネクタ組立体まで延びる前記複数のピンの一部は、シリコーンで覆われる、請求項9に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項11】

前記ピンは、Ti90/10を含む材料から構成される、請求項4に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項12】

前記少なくとも1つのコネクタ組立体は、複数のコネクタ接点を含み、前記複数のピンは、前記コネクタ接点に電気的に結合される、請求項4に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項13】

前記少なくとも1つのコネクタ組立体は、複数のコネクタ接点を含む、請求項1に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項14】

更に、前記少なくとも1つのコネクタ組立体を収容するシェルを有する、請求項1に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項15】

前記シェルは、縫合用孔を有し、前記縫合用孔は、前記シェルの両側の間を延び、ディボットによって包囲され、前記ディボットは、前記シェルの両側の各々に位置する前記シェルの外面に形成される、請求項14に記載の埋込み可能な神経刺激器。

【請求項16】

更に、前記回路基板及び前記可撓性回路を収容するケースを有する、請求項1に記載の埋込み可能な神経刺激器。